

证券代码：301319

证券简称：唯特偶



投资者关系活动记录表

编号：2023-011

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩沟通会（电话会） <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input checked="" type="checkbox"/> 现场参观 <input checked="" type="checkbox"/> 其他 <u>线上会议</u>
参与单位名称及人员姓名	东北证券 李玖、武芄睿、张禹；广发证券 赵什； 星石投资 杨英；交银施罗德基金 杨茉然；国泰 基金 张阳；创金合信基金 郭镇岳；西南证券自 营 刘淑娴；广发资管 刘文靓
时间	2023年11月9日
地点	公司会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理兼董事会秘书 桑泽林先生 证券事务代表 廖娅伶女士 证券事务专员 郜丽女士
投资者关系活动 主要内容介绍	<p>首先，公司董秘及证券事务代表向大家简要介绍公司的基本情况，包括公司产品、下游客户、技术特征等。其次，与调研对象进行互动交流，其主要关心问题及回复内容如下：</p> <p>Q1：公司产品的营收贡献情况大致情况是怎样？</p> <p>答：如2022年年报披露，公司产品营收贡献结构没有太大的变化，微电子焊接材料大概占85%左</p>

右，辅助焊接材料及其他大概占 15%左右。

Q2:公司在半导体封装领域具体的应用场景是什么？主要供应的产品是什么？

答：半导体封装工艺是要实现晶圆和电路的导电互联，可以通过用锡膏，焊片和银胶（浆）等材料实现。半导体是公司近年重点布局的发展的行业，起步较晚，目前占公司营收比例还较小。

Q3：目前行业壁垒主要体现在哪些方面呢？

答：（1）技术与工艺壁垒：微电子焊接材料行业属于技术密集型行业，涉及材料、物理、化学、机械、电子、自动控制等多个学科的交叉综合应用，而成熟的产品配方体系往往需要多年的积累，并且随着通讯、消费电子等下游行业的快速发展，势必要求微电子焊接材料更新换代速度不断加快，这对企业研发技术人员具备多种学科知识及掌握上下游行业的综合性学科知识提出了较高要求；（2）客户认证壁垒：作为电子材料行业的重要基础材料之一，微电子焊接材料的细微变化都可能会对终端产品的导电及连接性能产生严重影响，因此下游客户对微电子焊接材料供应商的认证非常严格，知名客户的认证周期通常耗时 1 至 2 年。出于对产品质量稳定性、转换成本等方面的综合考虑，下游客户一般不会轻易更换供应商。因此客户认证，特别是大客户认证对新进入的企业来说设置了较高的准入门槛；（3）资质壁垒：助焊剂、清洗剂等辅助焊接材料属于危险化学品，根据法律法规要求，相关生产企业必须取得危险化学品生产许可证、危险化学品经营许可证等诸多资质许可，而取得上述资质的难度较大、时间

	<p>较长。与此同时，是否具备高规格的研发中心及实验室，也是判断业内企业是否具备较强研发能力、能否获得知名客户认证的的重要标准。</p> <p>Q4：公司对于长尾客户的销售模式大部分采用直销，这个有什么考虑吗？</p> <p>答：首先，公司在前期发展阶段，战略主要以拓宽业务广度，提升品牌知名度为主。通过 25 年的积累，公司目前已基本实现对大多数行业和领域的覆盖。其次，由于微电子焊接材料及辅助焊接材料部分产品属于非标产品，需要根据客户的具体应用场景进行优化调整。因此，为了提供更好的客户服务体验，目前公司仍采用直销为主，经销为辅的销售模式。当前，公司正在逐步调整营销策略，加大对战略级和行业头部客户的深耕；同时也加大渠道合作伙伴的开发，以优化客户结构。</p> <p>接待过程中，公司与投资者进行了充分地交流与沟通，并严格按照公司有关制度规定，保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有出现未公开重大信息泄露等情况。</p>
附件（如有）	
日期	2023 年 11 月 10 日